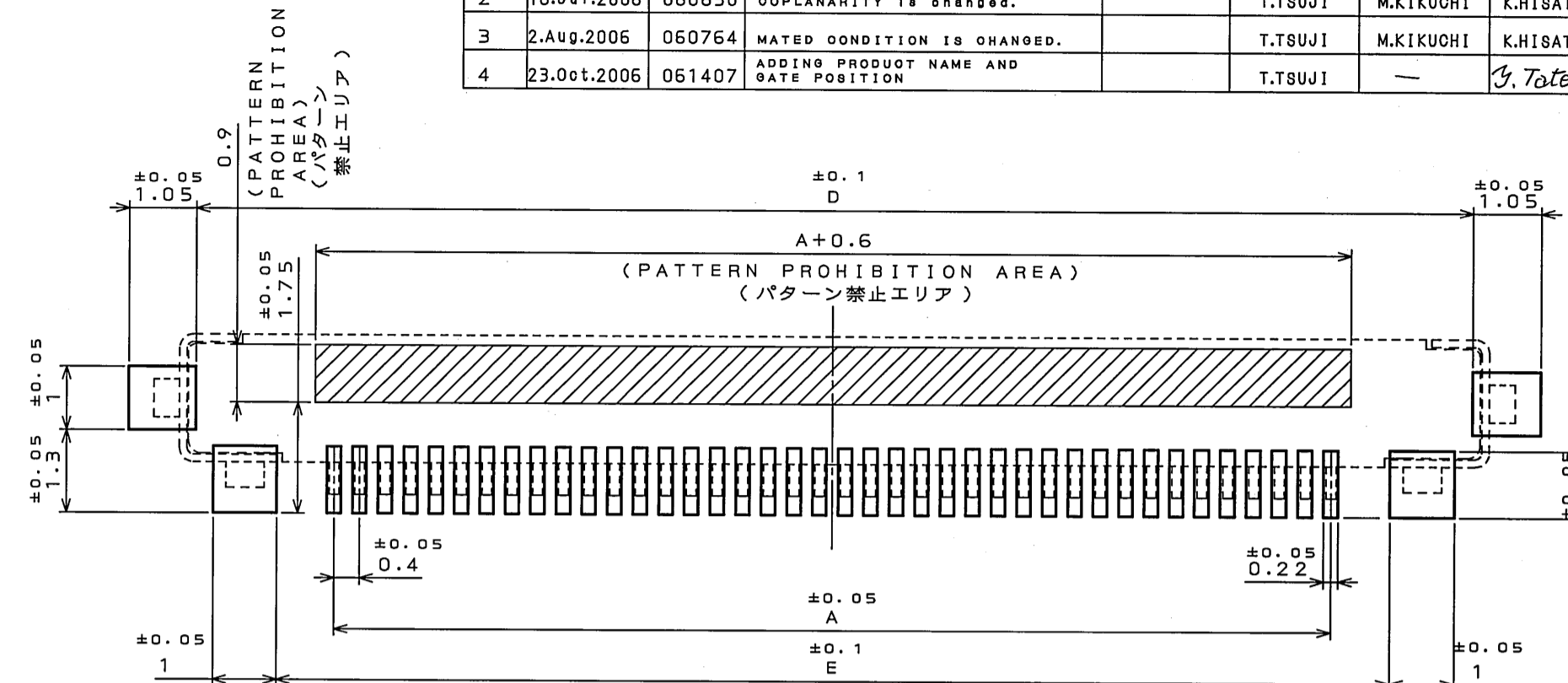
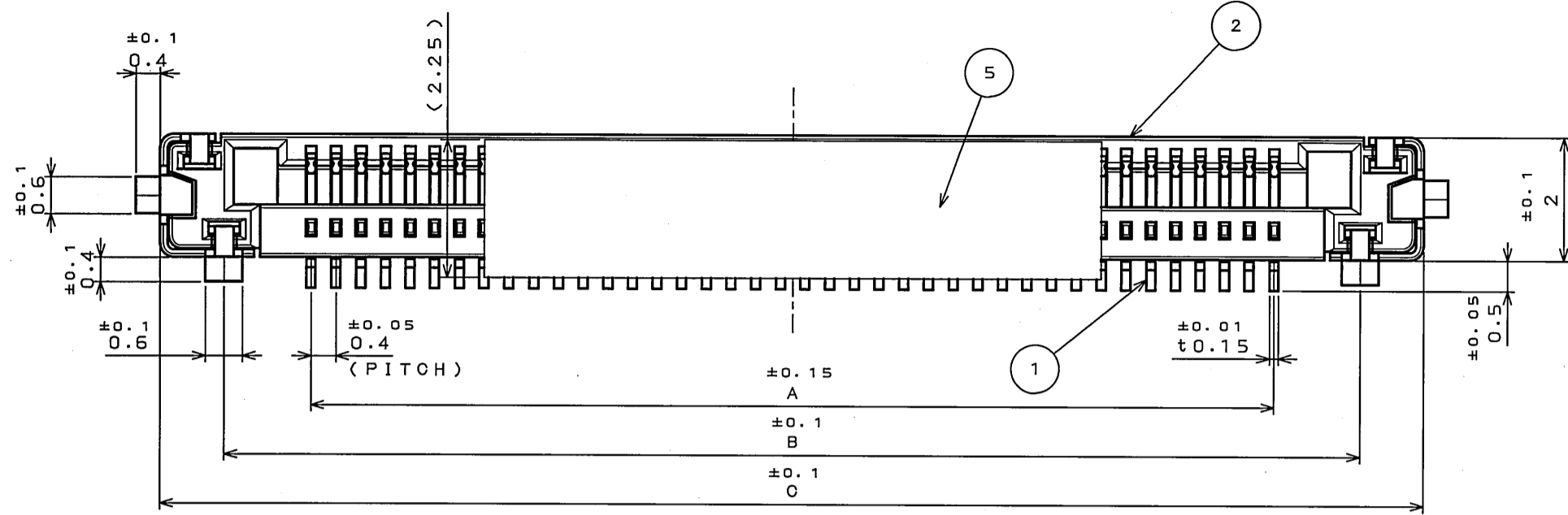
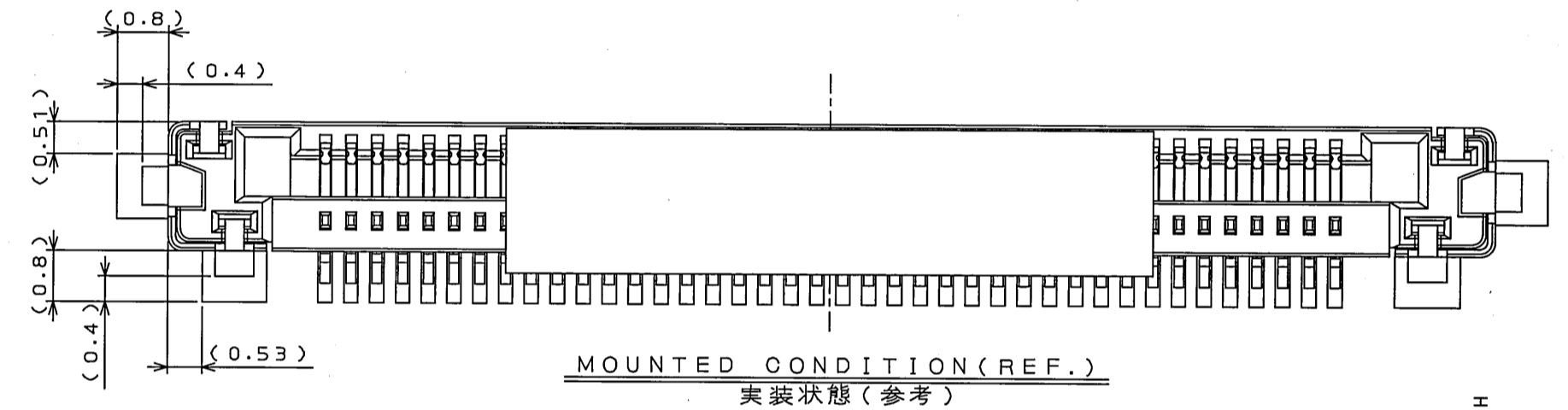
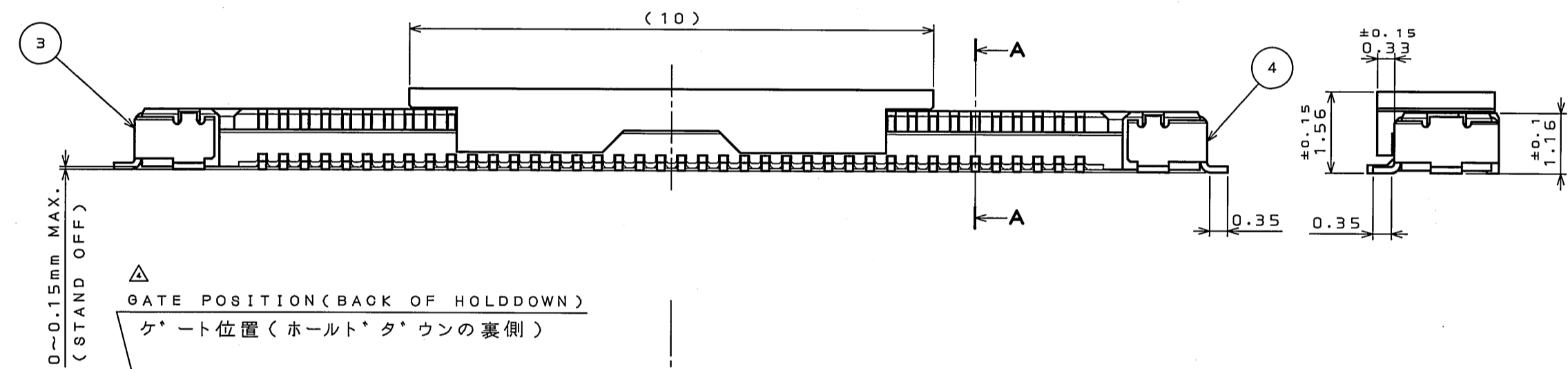


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	18.JUL.2006	060650	COPLANARITY IS CHANGED.		T.TSUJI	M.KIKUCHI	K.HISATOMI
3	2.AUG.2006	060764	MATED CONDITION IS CHANGED.		T.TSUJI	M.KIKUCHI	K.HISATOMI
4	23.OCT.2006	061407	ADDING PRODUCT NAME AND GATE POSITION		T.TSUJI		J. Tatebe

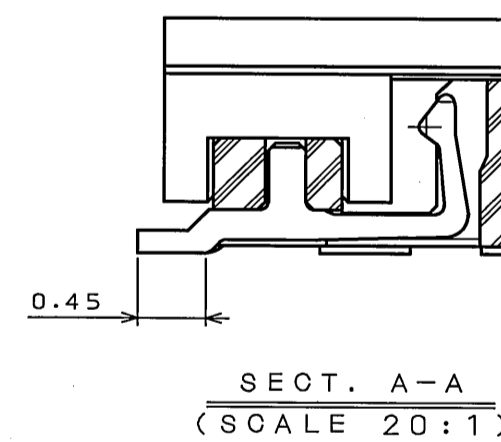


APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)  
適合基板寸法 (参考)

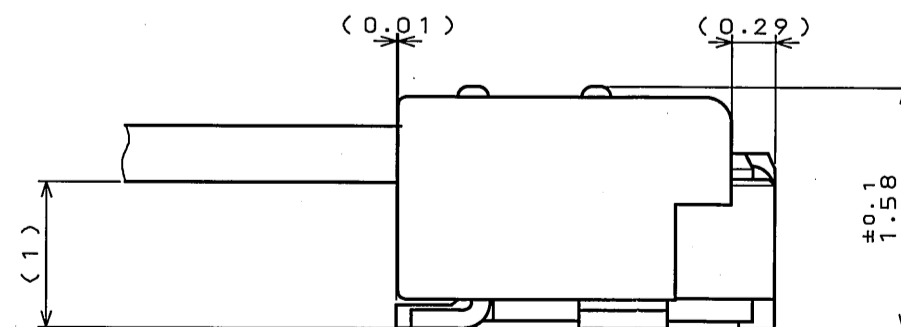
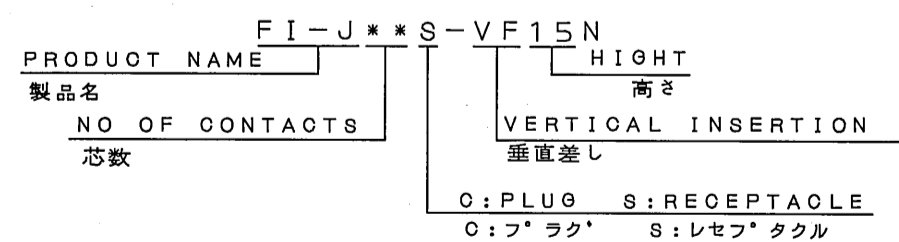


- NOTE 1. COPLANARITY BETWEEN TERMINAL AND HOLD DOWN SHOULD BE 0.08mm MAX.
- NOTE 2. PRODUCT NAME IS MARKED AS SHOWN IN BELOW FIGURE MARKING.
- 注 1. 端子及び、ホルツダウンの相互のパラツキは0.08mm以内とする。
- 注 2. 製品名の表記方法は下記による。

NO. OF CONTACTS	20	25	30	35	40
A	7.6	9.6	11.6	13.6	15.6
B	10.4	12.4	14.4	16.4	18.4
C	12.46	14.46	16.46	18.46	20.46
D	11.95	13.95	15.95	17.95	19.95
E	9.4	11.4	13.4	15.4	17.4



SECT. OF MATED CONDITION (REF.)  
嵌合状態断面図 (参考)



符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
5	VACUUM COVER 吸着用カバー	1	HEAT RESISTING PLASTIC 耐熱性プラスチック		UL94 V-0 BLACK 黒
4	HOLDDOWN R ホールツダウン右	1	COPPER ALLOY 銅合金		GOLD(0.1μMMIN)OVER NICKEL(1.5~3.0μM) NI(1.5~3.0μM)上AU(0.1μM以上)
3	HOLDDOWN L ホールツダウン左	1	COPPER ALLOY 銅合金		GOLD(0.1μMMIN)OVER NICKEL(1.5~3.0μM) NI(1.5~3.0μM)上AU(0.1μM以上)
2	INSULATOR インシュレーター	1	HEAT RESISTING PLASTIC 耐熱性プラスチック		UL94 V-0 BLACK 黒
1	CONTACT コンタクト	N	COPPER ALLOY 銅合金		GOLD(0.1μMMIN)OVER NICKEL(1.5~3.0μM) NI(1.5~3.0μM)上AU(0.1μM以上)

仕様書 (SPECIFICATION) 第1版 (ORIGINAL DATE) 28.NOV.2005  
製図 DR. 製図 (SCALE) 10:1  
担当 CHK. M.KIKUCHI  
査閲 APPD. 査閲 (SERIES) FI  
承認 APPD. K.HISATOMI  
承認 (TITLE) FI-J\*\*S-VF15N  
製品名 (PRODUCT NAME) FI-J\*\*S-VF15N  
重量 (MASS)

日本航空電子工業株式会社  
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.  
図面番号 (DRAWING NO.) SJ104705  
版数 (REV.) 4